

WAT 测试设备高增长，AI 算法在晶圆成品率相关应用研发完成

核心观点

公司 2022 年营收为 3.56 亿，同比增长 79.48%；归属于上市公司股东的净利润为 1.22 亿，同比增长 91.97%。营收和利润增长超预期，主要原因系核心业务 WAT 测试机加速放量。同时销售回款大幅度增加带来了良好的经营性净现金流水平。

公司 WAT 测试设备技术积淀深厚，具备核心技术卡位，产品性能得到越来越多的客户认可，2022 年 WAT 测试设备生产 67 台，销售 51 台，呈现产销两旺的良好局面。公司产品品类不断拓展，在 EDA 软件和电性测试方面都取得了产品品类的多元化拓展。AI 算法在晶圆成品率相关应用研发完成，有望带来全新的成长空间。

事件

公司披露 2022 年年度报告，公司 2022 年营收为 3.56 亿，同比增长 79.48%；归属于上市公司股东的净利润为 1.22 亿，同比增长 91.97%；扣除非经常性损益后的净利润为 1.03 亿，同比增长 104.01%。

简评

营收利润增长符合预期，公司保持高质量发展。根据公司 2022 年年度报告，公司 2022 年营收为 3.56 亿，同比增长 79.48%；归属于上市公司股东的净利润为 1.22 亿，同比增长 91.97%；扣除非经常性损益后的净利润为 1.03 亿，同比增长 104.01%。业绩符合预期，主要原因系核心业务 WAT 测试机加速放量。经营性净现金流 1.99 亿，远超 1.22 亿归母净利润，主要系销售回款大幅度增加。

WAT 测试设备快速放量，呈现产销两旺良好局面。近年来我国开启了晶圆厂的“建厂潮”，2021 至 2023 全球新建 84 座晶圆厂，大陆新厂预计数量第一，将给集成电路设备供应商、制造类 EDA 供应商等一系列为晶圆厂提供产品及服务的厂商提供了快速发展的契机。我们预估国内目前有 400-500 台 WAT 设备需求量，设备单价约 500 万，国内整体市场规模约 20-25 亿，可替代空间广阔。广立微率先实现 WAT 电学测试大规模商业化，其 WAT 电学测试设备经历十年研发及四代产品迭代，具有核心技术卡位，产品性能被越来越多的客户认可。根据年报信息披露，2021 年 WAT 测试设备生产量为 32 台，销售 20 台；2022 年生产量为 67 台，销售 51 台，新签订单量和设备交付量大幅度上升，2022 年合同负债 1.40 亿，2021 年同期只有 605 万，2022 年预收软件开发及授权和硬件产品销售费用合计 1.34 亿，WAT 测试设备呈现产销两旺的良好局面。

广立微 (301095.SZ)

维持

买入

于芳博

yufangbo@csc.com.cn

010-86451607

SAC 编号:S1440522030001

发布日期：2023 年 03 月 24 日

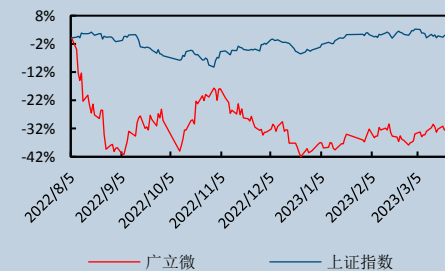
当前股价：105.54 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

	1 个月	3 个月	12 个月
	8.91/9.04	19.70/12.10	/
12 月最高/最低价 (元)			148.35/85.89
总股本 (万股)			20,000.00
流通 A 股 (万股)			4,206.21
总市值 (亿元)			211.08
流通市值 (亿元)			44.39
近 3 月日均成交量 (万)			218.41
主要股东			
杭州广立微股权投资有限公司			16.62%

股价表现



相关研究报告

2023-02-03 【中信建投人工智能】广立微 (301095): 利润增长超预期，成长空间进一步打开

产品品类不断拓张，实现全流程成品率提升。公司以 EDA 软件为起点，围绕成品率提升技术持续布局和拓展产品布局。在 EDA 软件方面，公司陆续研发推出了电性测试数据分析软件 DE-TMA、集成电路良率分析与管理系统 DE-YMS、集成电路缺陷管理系统 DE-DMS 的初版产品；在电性测试方面，公司的可靠性测试设备的研发取得关键性进展，WAT 测试设备通用机型 T4000 的架构得到优化，设备性能和性价比不断提升。公司的晶圆良率提升方案着力点不断增加，有望贡献未来的业绩增长新动能。

AI 算法在晶圆成品率相关应用研发完成。公司将 AI 算法与晶圆成品率相关数据结合，在应用层面上取得相应突破。其中包括：1) 公司使用神经网络算法进行数据分类和晶圆缺陷数据检测；2) 利用神经网络算法的泛化特点进行建模分析，实现晶圆成品率预测；3) 使用机器学习算法，构建各类数据之间的关联模型，以起到预测分析的效果（例如通过 WAT 数据预测 CP 良率，CP 的分类参数结果预测 ft 的良率）。4) 使用数据挖掘技术对各类数据进行系统化分析，并找出数据之间规律和关联性，以快速确定问题根源。

投资建议：公司在国产 EDA 软件和晶圆级电性测试领域积淀深厚，未来有望受益于国内晶圆厂扩产。我们预计，公司 2023-2025 年营业收入分别为 6.48 亿元、12.36 亿元和 20.22 亿元，同比增长率分别为 82.0%、90.7% 和 63.6%；归母净利润分别为 2.24 亿元、3.99 亿元、6.65 亿元，同比增长率分别为 83.6%、78.1% 和 66.7%；当前市值对应 PE 分别为 94x、53x 和 32x，维持“买入”评级。

风险提示：

下游需求不及预期。当前国家在半导体制造行业给予政策高度支持，下游需求旺盛，若未来下游需求增长由于各种因素导致不及预期，则可能会对公司业务收入增长造成不利影响。

疫情影响公司正常生产和交付。近期国内疫情反复，可能会对公司的正常生产交付产生不利影响，导致收入和增速不及预期。

客户集中度较高的风险。公司的前五大客户销售占比相对较高，客户主要为下游领域的晶圆代工厂，可能带来一定的业绩波动。

技术创新风险。技术研发过程存在一定的不确定性，可能导致收入不及预期。

分析师介绍

于芳博

中信建投人工智能组首席分析师，北京大学空间物理学学士、硕士，2019年7月加入中信建投，主要覆盖人工智能等方向，下游重点包括智能汽车、CPU/GPU/FPGA/ASIC、EDA和工业软件等方向。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10—10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
 东城区朝内大街2号凯恒中心
 B座12层
 电话：(8610) 8513-0588
 联系人：李祉瑶
 邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
 上海浦东新区浦东南路528号
 南塔2106室
 电话：(8621) 6882-1600
 联系人：翁起帆
 邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
 福田区福中三路与鹏程一路交
 汇处广电金融中心35楼
 电话：(86755) 8252-1369
 联系人：曹莹
 邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
 中环交易广场2期18楼
 电话：(852) 3465-5600
 联系人：刘泓麟
 邮箱：charleneliu@csci.hk